

高性能 玻璃载片 – 适用于半导体应用

几十年来,肖特凭借高品质的玻璃载片和基板赢得了无与伦比的声誉,为半导体、光电子、汽车、科学和生物技术等高科技行业提供多种产品。我们的专家致力于开发定制解决方案方面提供有力支持,以满足客户的特定需求。

我们的玻璃载片在先进的半导体应用中发挥着至关重要的作用,它们可作为硅晶圆和芯片的临时键合和解键合载片。肖特玻璃具有从紫外线到红外线的高透光率,可实现高效的激光辅助解键合,并支持多种先进的封装解决方案。

随着半导体架构变得越来越复杂,对稳定、超平整载片的材料需求也在持续增长。玻璃晶圆和基板越来越多地用于以下应用:

- 3D IC (三维集成电路)
- IGBT (绝缘栅双极晶体管)
- 扇出型晶圆级封装 (FOWLP) 和面板级封装 (FOPLP)



高品质原片玻璃



丰富的产品组合



多种产品形式



键合与解键合



直接用于半导体
后段制程

为什么选择肖特玻璃载片?

- **专为半导体工艺设计**
适用于临时键合、硅薄化和扇出型封装
- **无与伦比的精确度**
超低总厚度变化 (TTV) 和极小的翘曲度确保最大的工艺稳定性
- **卓越的光学特性**
从紫外线到红外线的高透射率,可实现先进的激光和光学处理
- **卓越的耐化学性**
具有高的耐酸、碱和水性,从而提高耐用性
- **广泛的热膨胀系数范围**
多种材料可供选择,确保与不同设备基板的最佳热膨胀匹配
- **工艺就绪设计**
激光打标、无尘室包装的晶圆和基板,可无缝集成到高科技制造中
- **严格的行业标准与无尘室处理**
 - 平边/缺口:符合SEMI标准
 - 激光打标:符合SEMI标准
 - 清洁:在ISO 5无尘室中进行超/兆声波清洁
 - 包装:在FOSB、RTU晶圆盒中按照ISO 5条件进行检验和包装
- **多种加工选项**
先进的加工能力可满足半导体载片晶圆和基板的各种需求。
- **专业技术**
我们的专家提供量身定制的支持,帮助客户找到最适合其应用的载片材料

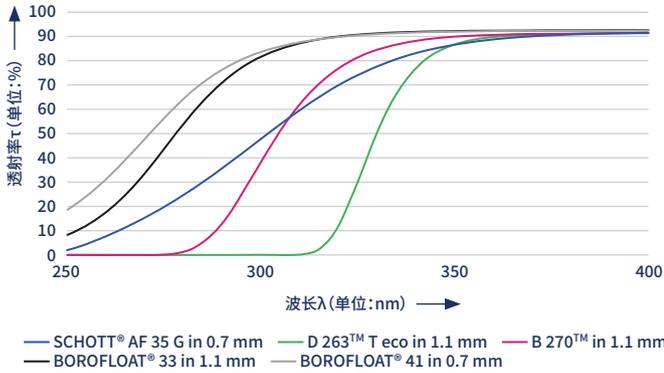
SCHOTT

凝智慧 享未来 肖特科技

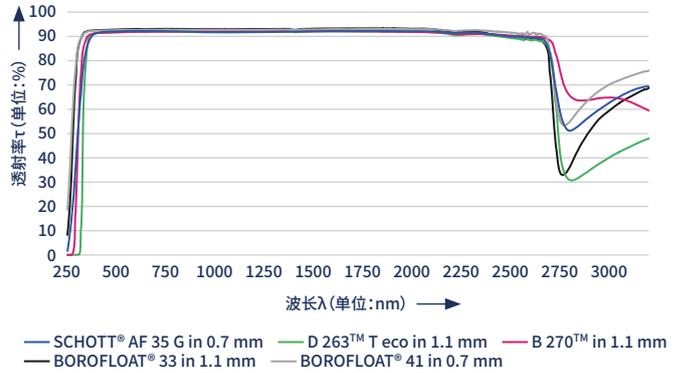
玻璃载片

我们的玻璃载片晶圆和基板凭借高品质加工工艺而令人信服

光谱透射率 $\lambda = 250 \text{ nm}$ 至 400 nm



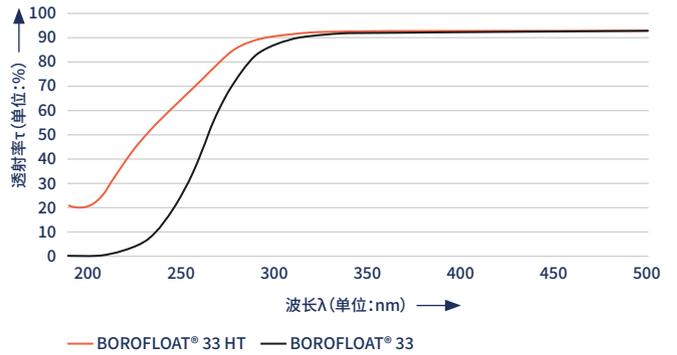
光谱透射率 $\lambda = 250 \text{ nm}$ 至 3200 nm



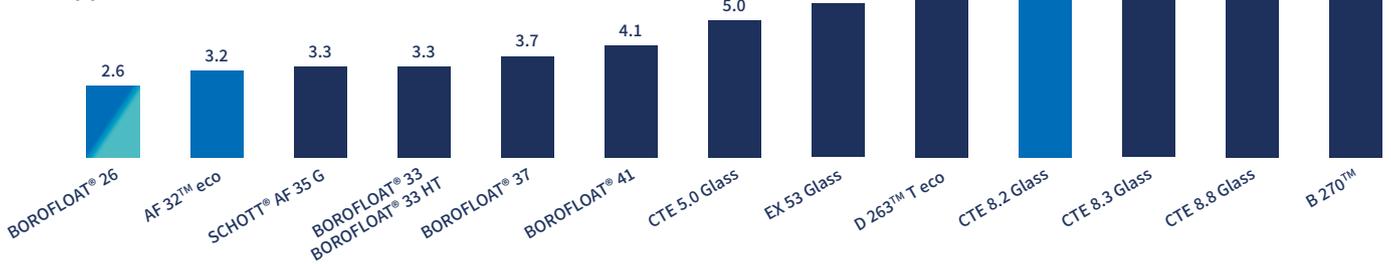
项目	晶圆	基板
规格*	6英寸、8英寸、12英寸 [150 - 300 毫米]	最大 650 x 650 mm
厚度	0.4 - 3.0 毫米	0.25 - 1.75 mm
总厚度变化 (TTV)	≤ 2.0 微米 (标准) ≤ 0.5 微米 (高级)	≤ 20 μm (标准) ≤ 15 μm (高级)
精确厚度公差	± 5.0 微米 (标准) ± 2.5 微米 (高级)	± 20 μm (标准) ± 10 μm (高级)
翘曲度	12英寸: ≤ 50 微米 8英寸: ≤ 30 微米	≤ 200 μm (标准) ≤ 100 μm (高级)
外观质量	40/20 (标准)	40/20 (标准)
划痕/凹坑	20/10 (高级)	20/10 (高级)

* 其他尺寸可根据要求提供

光谱透射率 $\lambda = 200 \text{ nm}$ 至 500 nm



CTE (ppm/K)



- 开发, 可提供晶圆和基板样品
- 可提供晶圆和基板样品
- 仅提供晶圆样品



CHINESE 03/2025 kn/nino Printed in Germany

schott.com

肖特(上海)精密材料和设备国际贸易有限公司, 上海市虹梅路1801号凯科国际大厦301室, 邮编:200233
 电话:+86 (0)21 3367 8000, 传真:+86 (0)21 3367 8080, info.china@schott.com

SCHOTT

凝智慧 享未来 肖特科技